

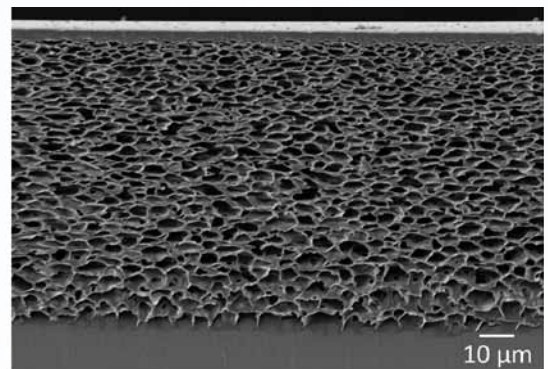
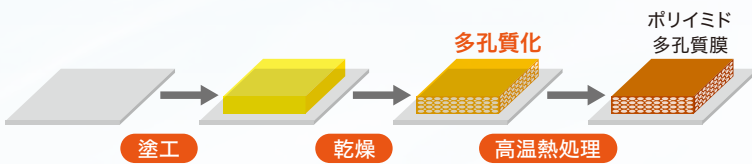
多孔質ポリイミド形成ワニス 開発品

Uイミド[®]ワニス

タイプBP

簡便プロセスによる ポリイミドの多孔質化を実現。

ユニチカ独自技術により、ポリイミド多孔質層の形成を容易におこなえる
ポリイミド前駆体(ポリアミック酸)溶液を開発しました。
通常のポリイミド被膜形成と同様の設備・プロセスにて、
ポリイミド多孔質層を得ることができます。



特長

簡便プロセス

塗工、乾燥、熱処理の一般的な加工設備で、ポリイミド多孔質被膜が得られます。

低環境負荷

多孔質層形成時に貧溶媒浸漬工程を必要とせず、廃液が発生しません。

多様な形状に対応

塗工性に優れたワニスであるため、基材形状を問わず(板状、フィルム状、チューブ状など)
ポリイミド多孔質被膜を形成できます。

用途例

- 分離材
- 断熱材
- 吸液材・液体保持材
- クッション材
- 低誘電率材
- セパレータ

特性例

			多孔質ポリイミド (BP ワニス被膜)	非多孔質ポリイミド (参考)	試験方法
一般特性	気孔率	%	70	0	
	弾性率	MPa	600	3000	ASTM D882 準拠
熱特性	熱収縮率 [200°C]	%	<0.1	0.2	JIS K 7133 準拠
	熱膨張率 [50 ~ 200°C]	ppm/°C	40	27	JIS K 7197 準拠
	熱伝導率	W/mK	0.04	0.16	JIS R 1611 準拠
電気特性	誘電率 [1MHz]	—	1.4	3.3	JIS K 6911 準拠
	誘電正接 [1MHz]	—	0.004	0.009	